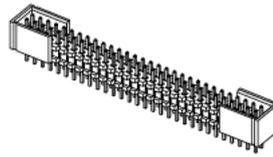


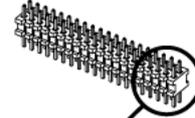
Mikro Stiftleisten

Serie FTSH

FTSH-130-02-L-D-ES



FTSH-120-02-F-D



FTSH-110-01-L-D-RA



Technische Daten:

Passend zu:
FFSD, CLP, FLE

Für eine vollständige Übersicht der technischen Daten siehe www.samtec.com?FTSH

Kontaktträger:

Liquid Crystal

Polymer, schwarz

Kontaktmaterial:

Phosphor Bronze

Nennstrom:

1,75 A bei 80°C

Betriebstemperatur:

-55° bis +125° C

Oberfläche:

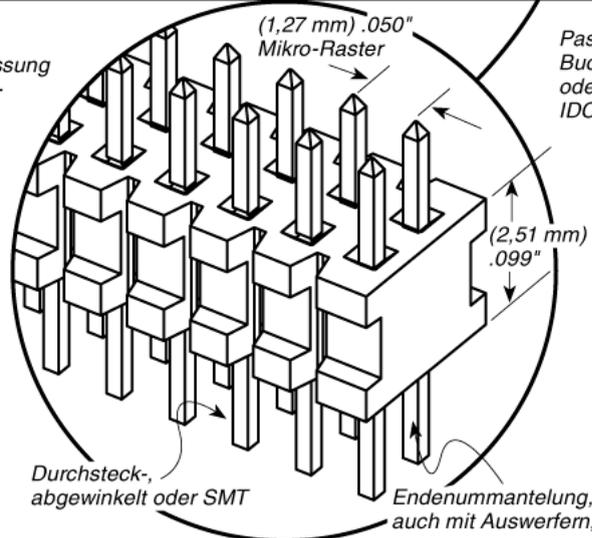
Sn oder Au über 50µ" (1,27µm) Ni



Anwendungsspezifische Optionen

Angespritzte Pick & Place Pads und einreihige Ausführungen lieferbar. Fragen Sie uns.

Impedanzanpassung für High-Speed-Anwendungen (in Verbindung mit Serie CLP)



Passend zu Buchsenleisten oder IDC-Kabel



Achtung: Siehe SFM/TFM für positive Ausrichten.

Verarbeitung:

Löttemperatur (max.):

60 Sek. / 230°C oder 3x

20 Sek. / 260°C

Bleifrei Lötbar:

Ja



www.samtec.com

FTSH	Kontakte pro Reihe	Leiterform	Kontaktmaterial	D	Anschlussoption	Optionen
	02 bis 50	Auswahl der Leiterform nach der Tabelle	- L = Kontaktbereich 10µ" (0,25 µm) Gold, Anschluss Matt Zinn - F = Kontaktbereich hauchvergoldet, Anschluss Matt Zinn	Für gerade Anschlüsse freilassen - RA = Abgewinkelt	- ES = Endenummantlung (nur LF -02 & -03) min. 9 Kont./Reihe - EP = Endenummantlung mit Führungspfeifen (nur LF -02 & -03) min. 9 Kont./Reihe - EL = Endenummantlung mit Platinenbef. (nur LF -02 & -03) min. 9 Kont./Reihe - EJ = Ummantlung mit Auswerfern (nur LF -01), min. 10 Kont./Reihe max. 25 Kont./Reihe nicht -RA - K = codierte Ummantlung (passend zu FFSD; nur LF -01; nur mit 05, 08, 10, 13, 15, 17, 20 & 25 Kont./Reihe; 13, 17, 20 & 25 Kont./Reihe mit Endenummantlung)	

Leiterform	A	OPTION	Z
- 01	(3,05) .120	- ES	(1,55) .061
- 02	(1,91) .075	- EJ	(15,77) .621
- 03	(1,65) .065	- EP	(5,87) .231
- 04	(3,81) .150	- EL	(6,53) .257